CHEMTRONICS
Technical Data Sheet

TDS # SWNoClean

Soder-Wick® No Clean Desoldering Braid

PRODUCT DESCRIPTION

Soder-Wick® No Clean is designed to provide fast and safe desoldering without leaving behind harmful flux residues. Soder-Wick® No Clean uses pure, oxygen free copper braid and a patented flux technology to make an efficient and effective desoldering braid. Soder-Wick® No Clean SD is available on ESD safe bobbins for protection against damage due to static electricity.

- Requires little or no post solder cleaning
- No corrosive residues
- Halide free
- ESD Safe bobbins meet specs:
  MIL-STD-1686C
  MIL-HDBK-263B
  Static decay provision of
  MIL-B-81705C
- Minimal risk of heat and static component damage

TYPICAL APPLICATIONS

Soder-Wick® No Clean safely removes solder from:

- Lugs and Posts
- Micro Circuits
- Surface Mount Device Pads
- Ball Grid Array Pads

TYPICAL PRODUCT DATA AND PHYSICAL PROPERTIES

Surface Insulation Resistance			
Bellcore TR-NWT-000078 : **PASS** After 96 Hours (megohms) 2×10^4 Limit			
Group A	Group B	Group C	
4.8×10^6	3.8×10^6	4.1×10^6	
ANSI/IPC J SF-818 : **PASS** After 168 Hours (ohms) 1.8×10^8 Limit			
1-2	2-3	3-4	4-5
2.3×10^{10}	2.6×10^{10}	2.8×10^{10}	2.8×10^{10}
Electromigration : **PASS** Average Insulation Resistance (megohms)-One Decade Limit			
	Initial	Final	
Group E	3.93×10^3	1.24×10^4	
Group F	3.87×10^3	2.84×10^4	
At 10x magnification no evidence of electromigration or heavy corrosion.			
Silver Chromate Test Paper **PASS**			
Copper Mirror Test **PASS**			
Shelflife **2 years**			

SODER-WICK® NO CLEAN MEETS OR EXCEEDS:
MIL-F-14256F, Type R
DOD-STD-883E, Method 2022
Bellcore TR-NWT-000078
ANSI/IPC J SF-818

Part #	Size Inches	Color	Size Metric
1	.030”	White	.76mm
2	.060”	Yellow	1.52mm
3	.080”	Green	2.03mm
4	.110”	Blue	2.79mm
5	.145”	Brown	3.68mm
6	.210”	Red	5.33mm
BGA	-	Purple	-

USAGE INSTRUCTIONS

For industrial use only.

Read MSDS carefully prior to use.

1) Choose a Soder-Wick® No Clean width equal to or slightly larger than the pad or connection.
2) Choose a solder iron tip equal to or slightly larger than the pad or connection.
3) Set temperature of iron between 600-750°F.
4) Place wick on solder joint and place tip of hot iron on top of wick.
5) As solder becomes molten, the color of the wick will change from copper to silver.
6) Remove wick and iron from joint simultaneously once color change has stopped.
7) The component lead / pad is now clean and free from solder.
8) Clip and discard used portion of the wick.

TECHNICAL & APPLICATION ASSISTANCE

Chemtronics provides a technical hotline to answer your technical and application related questions. The toll free number is: **1-800-TECH-401.**

AVAILABILITY

Part #	Size	Length	Part #	Size	Length
60-1-5	1	5	60-1-10	1	10
60-2-5	2	5	60-2-10	2	10
60-3-5	3	5	60-3-10	3	10
60-4-5	4	5	60-4-10	4	10
60-5-5	5	5	60-5-10	5	10
60-6-5	6	5			

VacuPak™ Packaging

The VacuPak™ Can contains ten five-foot bobbins in a vacuum sealed can. This package provides the highest level of cleanliness and freshness. Great for tool kit storage.

Part #	Size
SW16015	1
SW16025	2
SW16035	3
SW16045	4
SW16055	5
SW160BGA	BGA

NOTE:

This information is believed to be accurate. It is intended for professional end users having the skills to evaluate and use the data properly. Chemtronics does not guarantee the accuracy of the data and assumes no liability in connection with damages incurred while using it.

CHEMTRONICS
8125 COBB CENTER DRIVE
KENNESAW, GA 30152
1-770-424-4888

REV. F (08/13)

DISTRIBUTED BY:

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9